

普冉半导体（上海）股份有限公司

投资者关系活动记录表

（2026 年 9 月 21 日）

编号：2026-005

投资者关系活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☒ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☒ 路演活动 ☐ 现场参观 ☒ 其他
-----------	---

	<table><tr><td>Autonomy</td><td>Alpine</td><td>BEA Union</td></tr><tr><td>DE Shaw</td><td>Eastspring</td><td>First Beijing</td></tr><tr><td>ForwarEdge</td><td>Monolith</td><td>Morgan Stanley</td></tr><tr><td>North Rock</td><td>Pictet</td><td>Pinpoint</td></tr><tr><td>Polymer</td><td>Ubiquant</td><td>Millennium</td></tr><tr><td>Hel Ved</td><td>Bernice</td><td>ANATOLE</td></tr><tr><td>ODDO BHF</td><td>USS</td><td>社会公众投资者</td></tr></table>	Autonomy	Alpine	BEA Union	DE Shaw	Eastspring	First Beijing	ForwarEdge	Monolith	Morgan Stanley	North Rock	Pictet	Pinpoint	Polymer	Ubiquant	Millennium	Hel Ved	Bernice	ANATOLE	ODDO BHF	USS	社会公众投资者
Autonomy	Alpine	BEA Union																				
DE Shaw	Eastspring	First Beijing																				
ForwarEdge	Monolith	Morgan Stanley																				
North Rock	Pictet	Pinpoint																				
Polymer	Ubiquant	Millennium																				
Hel Ved	Bernice	ANATOLE																				
ODDO BHF	USS	社会公众投资者																				
时间	2026 年 9 月 2 日~9 月 18 日																					
地点	上证路演中心、公司现场接待、反路演、策略会																					
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理 王楠 董事会秘书、财务负责人 钱佳美 独立董事 陈卓 IR 张子怡																					
投资者关系活动主要内容介绍	一、董事长开场致词 尊敬的各位投资者，大家好！ 我是普冉股份董事长王楠，感谢大家拨冗参加普冉股份 2026 年半年度业绩说明会。出席本次会议的公司成员还有董事会秘书、财务负责人钱佳美女士和独立董事陈卓先生。今天，我们希望借助“上证路演中心”互动平台，与各位投资者做一次坦诚、深入的沟通交流。在此，我谨代表公司董事会和全体员工，向参加本次交流活动的朋友们表示欢迎，向长期关心和支持普冉股份发展的广大投资人致以诚挚的谢意！ 2026 年上半年，公司所处的半导体设计行业景气度持续上行，公司新品加速导入，新客户拓展和市场渗透的成效逐步显现。同时，受益于 AI 算力建设，海内外头部大厂产能持续被高端产品线挤占，行业供需格局持续偏紧，带动公司核心产品价格稳步抬升。 在行业格局加速走向头部化、集中化的关键窗口期，公司牢牢把握机遇，加大市场拓展力度，同时根据客户需求及时推进技术和产品创新，持续丰富和优化产品品类和结构，第二季度单季																					

	度营业收入及半年度营业收入均创下公司成立以来的新高。此外，公司已于 2025 年 11 月完成对诺亚长天 51%股权的收购交割。自 2025 年初以来，海外存储头部厂商陆续退出 2D NAND 市场，行业供需缺口变大，产品价格上涨，业绩向上弹性强，为公司 2026 年上半年营收和利润带来一定程度贡献。 2026 年上半年，公司实现营业收入 39.59 亿元，同比增长 336.67%；实现归母净利润 8.27 亿元，同比增长 1929.65%，扣非归母净利润 8.25 亿元，同比增长 2994.08%。 公司始终坚持高强度研发投入，重视产品研发创新和工艺深化，持续推进核心技术自主研发。2026 年上半年，公司研发投入达 2.26 亿元，同比增长 53.01%。截至上半年末，公司研发及技术人员较上年同期增加 21.48%，公司新申请专利及获得专利数持续增长。得益于持续增加的研发投入，公司整体研发能力快速提升，原有产品持续迭代、性能不断优化，新产品按计划实现量产，产品竞争力和产品线覆盖面进一步增强。在大容量 NOR Flash、EEPROM、MCU、VCM Driver 等产品线上，公司均实现了新产品或技术的突破，同时持续向高端工业、白电、车载、AI+等高端下游应用领域拓展。 公司持续夯实人才团队基础。2026 年上半年，公司继续实施了股权激励计划，各期激励计划的激励对象覆盖率已达全体在职员工的 80%以上，有效激发了员工的奋斗精神，也让员工切实感受到公司成长带来的回报和个人成就的提升。未来，公司将持续优化激励机制、深化培养体系、扩大激励覆盖，激发创新活力、夯实人才储备，为公司的长期发展凝聚合力。 2026 年上半年，公司三大战略齐头并进，共同构筑了公司高质量发展的新动能。存储主业层面，公司以先进工艺低功耗 NOR Flash 和高可靠性 EEPROM 为核心，实现对工业和车载应用的支持；立足主业，公司深化“存储+”战略，积极拓展通用微控制器和存储结合模拟的全新产品线；同时，公司通过外延并购纳入
--	--

	SkyHigh Memory，完善了公司第三条战略路线“存储 X”，进一步强化公司在存储领域的技术实力和市场竞争力。 面向未来，AI 产业浪潮深化创新，汽车电子智能化加速，国产替代迈向高端，存储行业前景广阔。公司将持续深化三大战略布局，加大核心技术研发投入，推进全球化布局，以存储主业筑牢发展根基、“存储 X”拓宽产业边界、“存储+”释放平台价值，构建三线协同、互为支撑的高质量发展体系。 我们衷心希望通过今天的交流，各位投资者能够更加全面、深入地了解公司的经营发展情况。欢迎大家踊跃提问，我们将竭诚为大家解答。 最后，再次感谢各位投资者对普冉股份的关注与支持。预祝本次业绩说明会圆满成功，谢谢大家！ 二、投资者交流环节 1、SHM 目前各业务的占比是多少？ SHM 专注于中高端应用的高性能 2D NAND 及衍生存储器领域。各产品线营收占比会随价格波动而有所变化，截至上半年 eMMC 占比相对较高，具体比例数据公司未单独披露。谢谢！ 2、请问公司今年有扩展其他业务的打算吗？ 公司持续围绕三大战略条线推进产品布局和业务拓展。在存储芯片领域，公司持续丰富和优化产品品类和结构；立足主业，公司深化“存储+”战略，积极拓展通用微控制器和存储结合模拟的全新产品线；同时，通过收购 SHM 的契机，逐步拓展第三条战略路线“存储 X”，进一步丰富产品线，强化公司在存储领域的技术实力和市场竞争力。谢谢！ 3、公司研发方面有多少投入，目前专利有多少？ 2026 年上半年，公司投入研发费用 2.26 亿元，同比增长
--	--

	53.01%。通过持续增加的研发投入，公司整体研发能力快速提升，原有产品迭代并实施性能优化，新产品按计划实现量产，产品竞争力和产品线覆盖面进一步增强。截至 2026 年 6 月 30 日，公司已获授权的发明专利达 77 项，集成电路布图设计证书 76 项，已经建立起了完整的自主知识产权体系。谢谢！ 4、请问贵司收购 SHM 剩余股权进展如何？ 截至目前，公司正在有序推进本次交易相关工作，具体进展请以公司后续相关公告为准。谢谢！ 5、随着海外存储厂商持续调整 2D NAND 产能，行业供给结构发生变化。SHM 目前的 2D NAND 及衍生存储器已面向中高端应用，公司未来将如何进一步推进相关产品向高端市场拓展？ 自 2025 年初以来，海外存储头部厂商陆续退出 2D NAND 市场，行业供需缺口变大，产品价格上涨。SHM 作为专注于中高端应用的高性能 2D NAND 及衍生存储器产品及方案的半导体企业，具备成熟的业务体系与独立经营能力。 未来，公司将依托 SHM 在技术和海外渠道方面的优势，推动 2D NAND 及衍生存储器产品向更高性能、更广容量范围发展，并通过工艺迭代、产品结构优化和高端客户拓展，提升中高端市场渗透率。同时，公司将根据全球存储市场供需变化，动态优化产品布局和资源配置。谢谢！ 6、请问目前公司与上游晶圆代工厂的合作情况如何？公司近期公告了高达 8 亿元的产能保障协议，这能为公司未来带来多大体量的产能支持？ 公司一直以来和上游晶圆厂、封测厂保持长期良好的战略合作伙伴关系。目前公司产能供给有所保障、排产有序，能够充分匹配当下饱满订单及后续出货增长需求。关于近期签订的产能保障协
--	--

	议，产能保障金总金额为 8 亿元人民币，具体对应的产能规模请以公司后续披露信息为准。谢谢！ 7、SHM 在海外市场具备一定的客户和渠道基础，公司未来是否会借助相关资源进一步拓展海外市场，并推动公司其他产品线进入海外客户供应链？ 公司与 SHM 在市场渠道方面具有较强的互补性。公司收入主要来自中国市场，SHM 则主要面向海外市场，双方渠道具有互补优势。 通过纳入 SHM，公司进一步拓展了全球存储市场。SHM 在韩国和日本设有工程中心，并在全球多地设有销售办事处，构建起完善的销售网络。未来，公司将结合相关市场资源，持续推进全球市场拓展及产品组合丰富。谢谢！ 8、今年以来存储市场景气度明显回升，公司如何看待本轮存储周期的持续性？ 本轮存储超级周期主要由 AI 驱动。随着大模型从训练走向推理和 AI 智能体应用不断涌现，AI 基础设施产生海量数据存储与高速访问需求。国际头部 IDM 存储大厂优先将产能、扩产资源及先进工艺布局投向市场空间更广、技术壁垒更高的高端存储产品，对通用消费级内存及其他存储产品线的产能供给产生影响。受到供给和需求双向挤压的作用，本轮存储产品量价齐升。从目前情况来看，AI 需求仍在持续增长，行业供需格局短期内仍有望维持偏紧状态，存储市场景气度具备一定持续性。 公司将持续关注行业供需格局变化，依托工艺迭代保持性价比优势，通过大容量 NOR Flash、车规及工控产品、高端模拟产品等结构升级夯实盈利基础。谢谢！ 9、公司目前各产品线的发展情况如何？如何看待未来主要
--	---

	的增长点？ 目前，公司持续推进三大战略条线。在存储芯片领域，公司持续丰富和优化产品品类和结构，大容量 NOR Flash 等产品逐步放量；在“存储+”战略下，公司积极拓展通用微控制器和存储结合模拟的全新产品线，MCU、Driver 等新产品逐步放量；通过外延并购纳入 SHM，完善“存储 X”战略，进一步丰富公司的产品线。 未来，公司将围绕三大战略条线推进产品布局和业务拓展。在存储芯片领域，公司将加快大容量 NOR Flash、高可靠性 EEPROM 等产品向工控、通信、PC、服务器、汽车电子等应用领域拓展；在 MCU 及模拟产品领域，持续完善基于 M0+、M4 内核的产品矩阵，推进车规级 MCU、VCM Driver、SPD/TS 等产品的客户导入和规模化出货。 此外，公司将结合市场需求和产品发展情况，持续推进产品结构优化，培育新的业务增长点。谢谢！ 10、公司如何看待 AI 产业发展对 NOR Flash、NAND 等存储产品需求的带动作用？ AI 相关需求已经在公司多个产品和应用领域逐步体现。从公司产品来看，2Mbit EEPROM 已有产品批量应用于高速宽带通信和数据中心；256Mbit~1Gbit 大容量 NOR Flash 已加速导入 PC、服务器等大客户，后续将推广和应用用于智能音频/音响、传统/AI 服务器、新能源车智能驾驶、ADAS 系统、中央域控等场景。此外，大容量 NOR Flash 和 2D NAND 也在向 5G 基站、汽车座舱及控制单元、工业自动化控制器、边缘 AI 等场景拓展。谢谢！ 11、VCM Driver、SPD/TS 是公司重点拓展的模拟配套产品线，请介绍两条业务目前的出货、客户导入进展以及成长空间？ VCM Driver 业务方面，公司目前多款开环的音圈马达驱动芯
--	--

	片产品均已量产出货，成功导入多家品牌手机客户，市场份额显著提升。第二代分离式 OIS 芯片及面向主摄长焦及潜望镜头的新一代 OIS 芯片均实现大批量量产。此外，公司推出首款闭环驱动芯片，可满足大行程应用需求，适配折叠屏、潜望式摄像头等高端应用场景。 SPD 及 TS 产品主要配套新一代 DDR5 内存条，应用于计算机和服务器内存条。2026 年上半年，公司 SPD 及 TS 产品稳步进行市场拓展，已经完成多家客户的批量出货，重点大客户已经完成验证并量产出货。随着 DDR5 内存模组渗透率持续提升，SPD/TS 作为内存条的关键配套芯片，其市场需求有望同步增长，公司将持续推进客户拓展与量产交付。谢谢！
附件清单（如有）	无
日期	2026 年 9 月 21 日